



2024年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年8月2日

上場会社名 株式会社 東京精密

上場取引所 東

コード番号 7729 URL <https://www.accretech.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長COO (氏名) 木村 龍一

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長CFO (氏名) 川村 浩一

TEL 042-642-1701

四半期報告書提出予定日 2023年8月4日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	26,618	4.7	4,250	25.3	4,710	27.5	3,245	32.6
2023年3月期第1四半期	27,919	3.2	5,691	4.9	6,496	8.1	4,812	10.5

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 3,954百万円 (32.3%) 2023年3月期第1四半期 5,839百万円 (23.2%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第1四半期	80.63	79.78
2023年3月期第1四半期	118.38	117.29

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第1四半期	201,775	144,080	70.6
2023年3月期	209,032	146,028	69.0

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 142,456百万円 2023年3月期 144,288百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		109.00		126.00	235.00
2024年3月期					
2024年3月期(予想)		85.00		85.00	170.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	61,000	14.2	11,000	29.9	11,000	33.6	8,000	32.8	198.90
通期	129,000	12.1	24,000	30.4	24,000	32.0	17,000	28.1	422.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期1Q	41,990,181 株	2023年3月期	41,903,281 株
期末自己株式数	2024年3月期1Q	1,712,578 株	2023年3月期	1,529,552 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期1Q	40,257,553 株	2023年3月期1Q	40,654,243 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっては、添付資料1「当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予想情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、企業業績は回復傾向にあるものの、ウクライナ情勢に端を発する資源・エネルギーや原材料の入手難と価格上昇への波及、インフレ抑制策としての欧米各国における金融引き締め継続、これに起因した為替相場変動など、引き続き不透明な状況が続いています。

このような状況下、当社を取り巻く環境は、半導体製造装置部門の取引先である半導体やハイテク関連企業においては、設備稼働率に底打ちの兆しは見られるものの、投資意欲は依然として慎重な姿勢が続く、計測機器部門の取引先である多種多様なものづくり業界の設備投資は、業種による需要動向のバラツキが大きい状況でした。その結果、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、受注高 295 億 71 百万円、(前年同期比 35.9% 減)、売上高 266 億 18 百万円 (前年同期比 4.7% 減) となり、営業利益 42 億 50 百万円 (前年同期比 25.3% 減)、経常利益 47 億 10 百万円 (前年同期比 27.5% 減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は 32 億 45 百万円 (前年同期比 32.6% 減) となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメント別概況は以下の通りです。

【半導体製造装置部門】

半導体製造装置部門では、引き続き SiC などのパワー半導体向け需要、ウェーハ増産向け需要は堅調に推移したものの、スマホ、PC、テレビなどの民生エレクトロニクス製品の低迷による、メモリデバイスや電子部品向け装置需要が低調に推移したことで、受注高は前年同期比で減少しました。

受注残高は高水準で生産面では高稼働を維持したものの、納期スケジュールの関係や一部顧客の延伸要請などにより、売上高は前年同期比で減少しました。

この結果、当部門における当四半期の受注高は 203 億 45 百万円 (前年同期比 43.4% 減)、売上高 187 億 22 百万円 (前年同期比 11.4% 減)、営業利益は 32 億 8 百万円 (前年同期比 36.5% 減) となりました。

【計測機器部門】

計測機器部門では、EV の開発需要や、二次電池用の充放電試験装置の需要に動きがみられましたが、当社が新規分野として注力している半導体製造装置など一部の分野で設備投資の手控え傾向がみられたことから、受注高は前年同期比で減少しました。

生産面では、前連結会計年度に受注を獲得した案件の生産が堅調に推移したほか、計画通りの出荷・据付を実行したことで、売上高は前年同期比で増加しました。

この結果、当部門における当四半期の受注高は92億25百万円(前年同期比10.0%減)、売上高78億95百万円(前年同期比16.4%増)、営業利益は10億42百万円(前年同期比62.4%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

【資産、負債及び純資産の状況】

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ72億57百万円減少し、2,017億75百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少116億47百万円、製品、原材料、仕掛品などの棚卸資産の増加90億71百万円、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権の減少48億46百万円、有形固定資産の増加39億円等です。

当第1四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ53億9百万円減少し、576億95百万円となりました。その主な要因は、未払法人税等の減少43億94百万円、支払手形及び買掛金、電子記録債務の減少28億94百万円、契約負債の増加25億39百万円、賞与引当金の増加14億7百万円、借入金の減少10億円等です。

当第1四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ19億47百万円減少し、1,440億80百万円となりました。自己資本比率は、70.6%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期の業績予想につきましては、前回発表時(2023年5月12日)の見通しを変えておりません。

(注) 業績見通し等の将来に関する記述は、内外の経済状況、為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,080	28,433
受取手形、売掛金及び契約資産	36,401	29,837
電子記録債権	7,002	8,719
商品及び製品	2,462	3,129
仕掛品	32,862	38,107
原材料及び貯蔵品	18,156	21,317
その他	7,063	3,019
貸倒引当金	△ 57	△ 2
流動資産合計	143,972	132,562
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	16,624	16,562
その他(純額)	32,329	36,291
有形固定資産合計	48,954	52,854
無形固定資産		
のれん	279	275
その他	3,672	3,832
無形固定資産合計	3,951	4,107
投資その他の資産		
その他	12,267	12,362
貸倒引当金	△ 112	△ 112
投資その他の資産合計	12,154	12,250
固定資産合計	65,060	69,213
資産合計	209,032	201,775

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,164	10,138
電子記録債務	12,194	9,326
短期借入金	1,300	1,300
1年内返済予定の長期借入金	4,000	3,000
未払法人税等	6,324	1,929
契約負債	8,703	11,243
賞与引当金	2,636	4,044
役員賞与引当金	9	91
その他	5,615	4,608
流動負債合計	50,947	45,681
固定負債		
長期借入金	8,000	8,000
役員退職慰労引当金	57	51
退職給付に係る負債	1,248	1,250
訴訟損失引当金	1,914	1,914
資産除去債務	65	65
その他	771	731
固定負債合計	12,057	12,013
負債合計	63,004	57,695
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,064	11,195
資本剰余金	22,179	22,313
利益剰余金	114,005	112,161
自己株式	△ 7,098	△ 8,016
株主資本合計	140,150	137,653
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	510	671
為替換算調整勘定	2,619	3,161
退職給付に係る調整累計額	1,007	969
その他の包括利益累計額合計	4,137	4,803
新株予約権	1,072	913
非支配株主持分	668	710
純資産合計	146,028	144,080
負債純資産合計	209,032	201,775

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
売上高	27,919	26,618
売上原価	15,940	15,415
売上総利益	11,978	11,203
販売費及び一般管理費	6,287	6,952
営業利益	5,691	4,250
営業外収益		
受取利息	7	10
受取配当金	35	32
為替差益	401	345
投資事業組合運用益	172	100
受取補償金	165	16
その他	41	59
営業外収益合計	824	563
営業外費用		
支払利息	10	24
固定資産除売却損	1	67
その他	6	12
営業外費用合計	18	103
経常利益	6,496	4,710
特別利益		
新株予約権戻入益	5	6
投資有価証券売却益	-	19
特別利益合計	5	26
税金等調整前四半期純利益	6,502	4,736
法人税、住民税及び事業税	1,672	1,411
法人税等調整額	△12	45
法人税等合計	1,660	1,456
四半期純利益	4,842	3,279
非支配株主に帰属する四半期純利益	29	33
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,812	3,245

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
四半期純利益	4,842	3,279
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	33	161
為替換算調整勘定	981	550
退職給付に係る調整額	△18	△37
その他の包括利益合計	996	674
四半期包括利益	5,839	3,954
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,788	3,911
非支配株主に係る四半期包括利益	50	42

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(1) 自己株式の取得

当社は、2023年2月6日開催の取締役会決議に基づき、当第1四半期連結累計期間に自己株式182,400株の取得を行いました。単元未満株式の買取による取得も含め、当第1四半期連結累計期間において自己株式が918百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株式が8,016百万円になりました。

なお、当該決議に基づく自己株式の取得は、2023年4月28日をもって終了しています。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

前第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	21,135	6,783	27,919
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	21,135	6,783	27,919
セグメント利益	5,049	641	5,691

(注)セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

当第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	18,722	7,895	26,618
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—
計	18,722	7,895	26,618
セグメント利益	3,208	1,042	4,250

(注)セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

以上